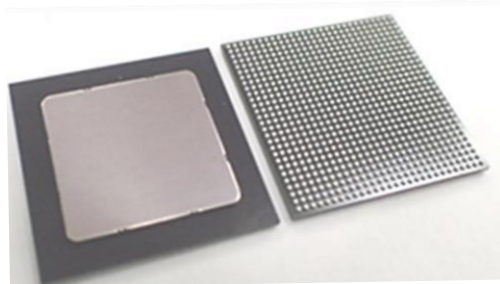


ヒートスプレッダー付きフリップチップパッケージ

概要

ICチップ裏面からTIM（Thermal Interface Material）を介してヒートスプレッダー（放熱版）に直接熱を逃がす、高い放熱機能を持った構造のフリップチップパッケージを提供しています。

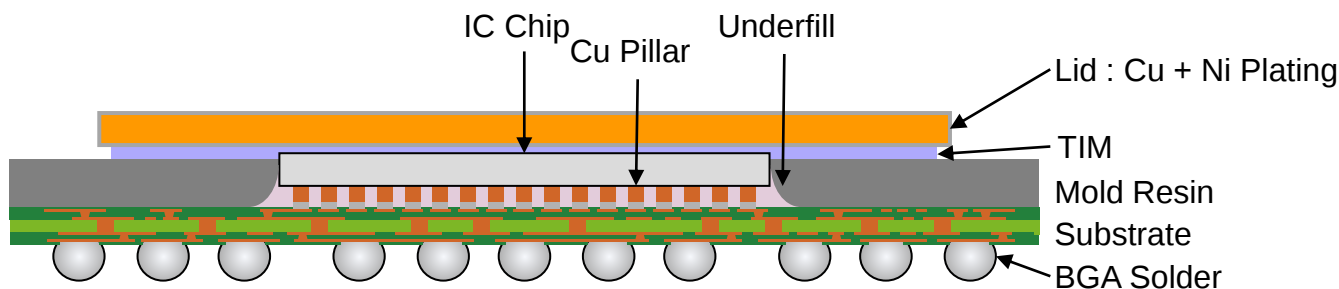


特徴

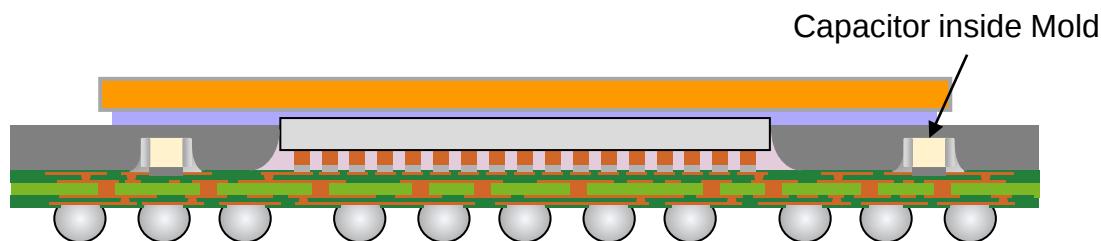
- ・ モールド樹脂からチップ背面を露出させ、ICチップの発熱をヒートスプレッダーに放熱させる構造
- ・ ヒートスプレッダーに自社製リードフレームを採用することで高品質・低価格を実現
- ・ 高密度・狭ピッチの高機能多ピンICチップに対し各種フリップチップ接続にて対応
- ・ ICチップ周囲をモールド樹脂充填構造にすることで、薄基板を用いながら低反り化を実現
- ・ 4～6層 200 μm コア基板等にも対応可
- ・ AEC-Q100 Grade 2対応。車載用途に採用実績あり

構造

■ 基本構造



■ 応用例：キャパシタ内蔵（開発中）



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町80

お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。

<https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php>



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN

Please contact us via inquiry form on the web.

<https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php>

